附件1

2023第七届世界智能大会双边会谈

项目信息征集表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称** |  |
| **项目名称** |  |
| **行业类别** | □ 信创 □ 集成电路 □ 车联网 □ 生物医药□ 中医药 □ 新能源 □ 新材料 □ 航空航天□ 高端装备 □ 汽车及新能源汽车 □ 绿色石化 □ 轻工 |
| **企业属性** | □ 国有企业 □ 民营企业 □ 混合所有制企业□ 合资企业 □ 外资企业 |
| **对接需求** | □ 投融资对接 □ 技术合作 □ 贸易洽谈 □ 政策咨询 □ 人才交流 □ 招商引资 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **联 系 人** |  | **职 务** |  |
| **联系电话** |  | **邮 件** |  |
| **项目简介（150字内）** |
|  |

请回传至电子邮箱：cq@wicongress.org

附件2

2023第七届世界智能大会双边会谈

对接人员反馈表

|  |
| --- |
| **报送单位：**  |
| **序号** | **各级负责人** | **姓名** | **职务** | **联系方式** | **电子邮箱** |
| **1** | **牵头工作部门** |  |  |  |  |
| **负责同志** |
| **2** | **联络员** |  |  |  |  |
| **联系人：**  **电话：** |

请回传至电子邮箱：cq@wicongress.org